

### 3.3.2. 多核互融架構

多核心微處理應用架構係繼承於雙核心微處理應用架構，並承襲了淬鍊成熟的適用層及應用層的基礎設計，繼而衍生出新的設計參考模型(如圖 3-3 所示)，並依據新產品開發計畫之訴求，達成以下三項技術指標：

- (1) 平台互融 - 整合兩組非同質性結構 (Non-Homogeneous Structure) 平台各自定義的高效能微處理控制單元 (MCU)，建立並聯式平台互融及多核交叉複決容錯備援的應用架構設計，不僅滿足平台互融容錯備援機制的需求，同時應符合階層式高效能應用程式運行效率的要求。
- (2) 交叉複決 - 設備電路運作應足以具備三個以上監控單元，以交叉存取控制 (Cross Access Control) 電路並聯結構整合運作，提供交叉複決容錯備援機制運作功能，讓路口現場設備可靠度推升至航空安全等級，充分提升戶外型設備運轉及運營維護作業的高可靠度與持久性。
- (3) 彩色觸控 - 選用高解析度 (480x320 畫素) TFT 全彩液晶觸控畫面設計，提供更具親和性的彩色觸控操作界面服務。

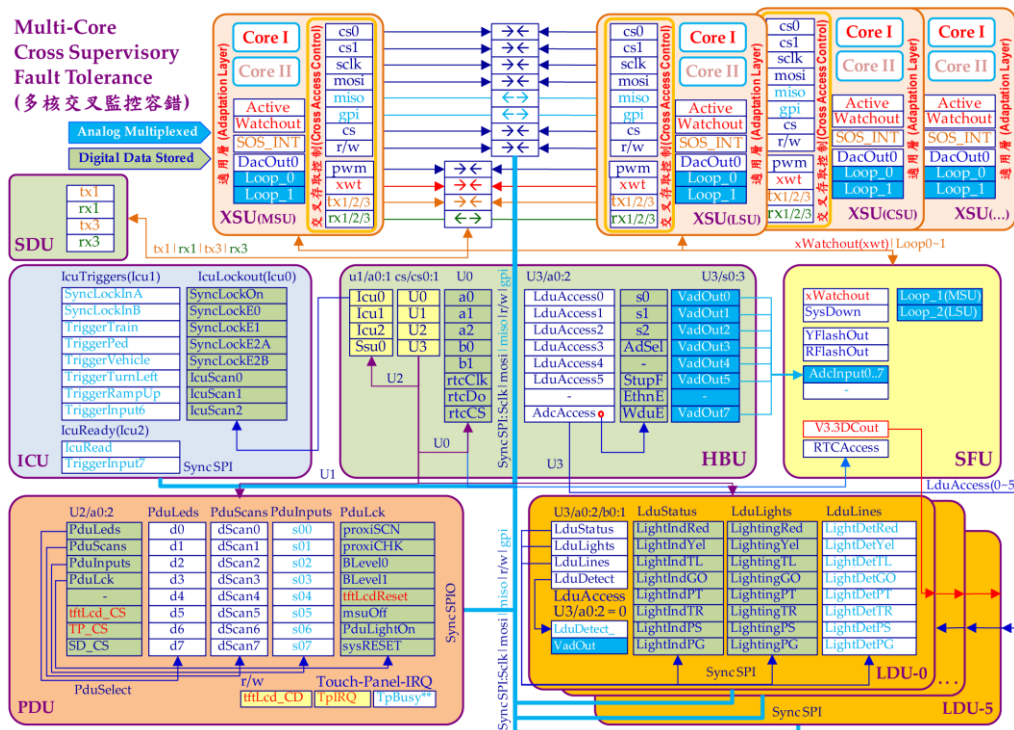


圖 3-3 多核心微處理應用架構設計參考模型